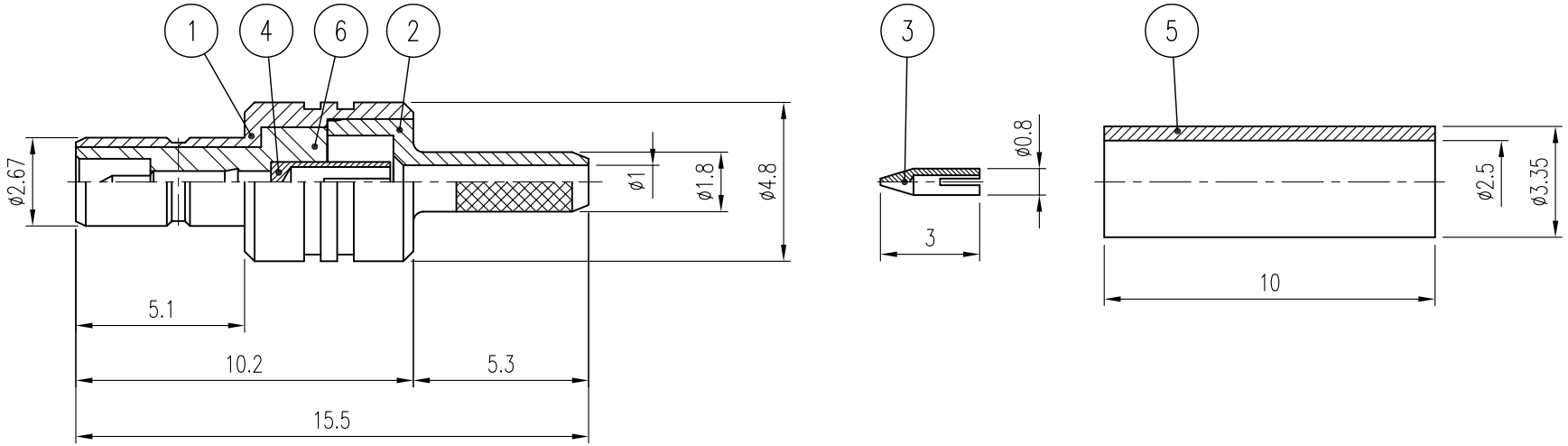
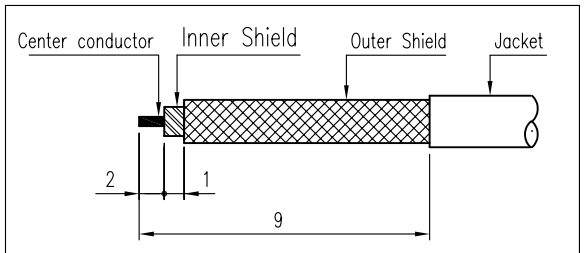
가공 / ST										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일





* CABLE 탈피도

품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
6	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01409-N/1
5	FERRULE	1	MBsBD	Nickel Plate	DFE00018-5/2
4	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT01742-5/1
3	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00100-5/1 (E2007)
2	BODY (B)	1	MBsBD	Nickel Plate (5㎛이상)	DBD01972-5/1
1	BODY (A)	1	SUS303	부동태 처리	DBD02218-5/1

대체가능재질

공통공차
.* ±0.1
.** ±0.05

재질 _____

열처리 _____

보호피막처리 _____

년월일 2008. 10. 30.

승인

검도

제도

작성부서 연 구 소

척도 5/1 단위 mm 중량 ___

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 SSMB-JC-RG178

A4

도번 CN02212-7/1